

OPEN INNOVATION - Exploit my Patent

Evento MESAP

12.05.2023



Electronics



Helicopters



Aircraft



Cyber &
Security



Space



Unmanned
Systems



Aerostructures

Open Innovation

Per Leonardo Open Innovation significa aprirsi all'interazione e alla collaborazione, sia al proprio interno, sia con realtà innovative esterne.

Alla base, costanti investimenti in ricerca e sviluppo, decisivi per l'evoluzione dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, settore strategico per il progresso della comunità globale.



12.200

persone
dedicate alle attività di Ricerca & Sviluppo



11

Leonardo Labs
per lo sviluppo di tecnologie innovative



4

Joint lab
con partner industriali e istituzionali



DAVINCI-1

supercomputer
tra i più potenti al mondo nel settore AD&S



€2,0 MLD

investiti in Ricerca e Sviluppo nel 2022



62%

dipendenti
con titolo di studio STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)



Open Innovation

Leonardo svolge le attività di ricerca nell'ambito di un network globale di oltre 70 centri di ricerca e università, e un numero crescente di partner, imprese e start up impegnate insieme nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.

Un ecosistema in cui far crescere il talento e la creatività delle persone

- scambi di idee,
- Interdisciplinarietà
- modalità di interazione innovative



Open Innovation

Leonardo promuove attività di networking che coinvolgono università, centri di ricerca e un numero crescente di partner, imprese e start-up su scala globale

CALL FOR ENTREPRENEURSHIP



Iniziativa interna, dedicata a tutta la popolazione di Leonardo, volta a far emergere idee di business innovative

7drone contest

an open innovation challenge by Leonardo

Ideato e sviluppato in collaborazione con sei atenei italiani



Business Innovation Factory

Acceleratore di start up, realizzato in partnership con LVenture Group, per sviluppare soluzioni innovative in grado di ampliare l'offerta di servizi nell'Aerospazio Difesa & Sicurezza

www.leonardoaccelerator.com

7nnovathon

a marathon of ideas for Leonardo

Maratona di idee che si svolge secondo la modalità dell'hackathon: sfide tecnologiche volte a promuovere e realizzare soluzioni creative e a trarre ispirazione per nuovi prodotti e servizi.



Solvers Wanted

Piattaforma di scouting

Challenge e co-challenge in evidenza

CO-CHALLENGE

GCAP ACCELERATION INITIATIVE

Una market exploration del Ministero della Difesa assieme a Leonardo, Cofriol, AIAD e le altre aziende leader dei domini di settore come Avio Aero, Elettronica, MBDA Italia. GCAP (Global Combat Air Programme) tecnologie e piattaforme di...

[Scopri](#)

[SCOPRI TUTTE LE CHALLENGES](#) → [SCOPRI TUTTE LE CO-CHALLENGE](#) →

Le nostre challenge e co-challenge

CHIUSE

PILOT PERFORMANCE MONITORING

La Challenge di Leonardo indirizzata alla ricerca di soluzioni e tecnologie innovative inerenti al monitoraggio dello stato di salute psico-fisica dei piloti.

[Scopri](#)

IN CORSO

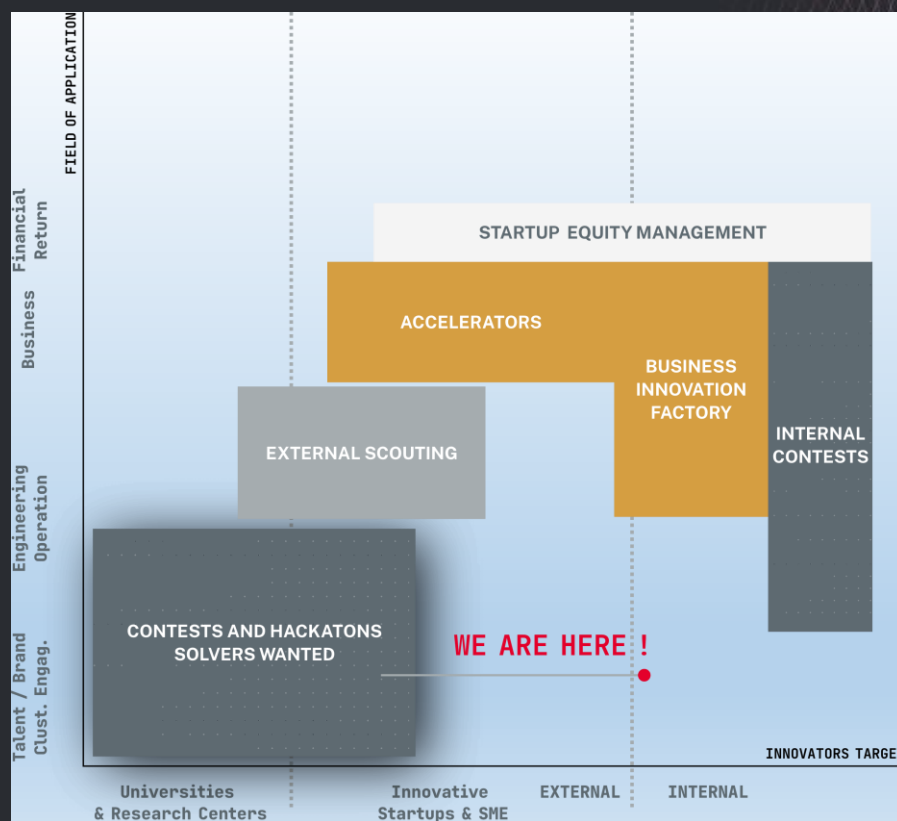
CO-CHALLENGES

FONDAZIONE COTEC INSIEME A LEONARDO, ENEL E ENI

Sistemi di sicurezza per rilevare i segnali di allarme in autisti, operatori e lavoratori sul campo.

[Scopri](#)

Aperta a Università, Spin-Off, Start Up, PMI (innovative e non), Centri di Ricerca



**SOLVERS
WANTED**

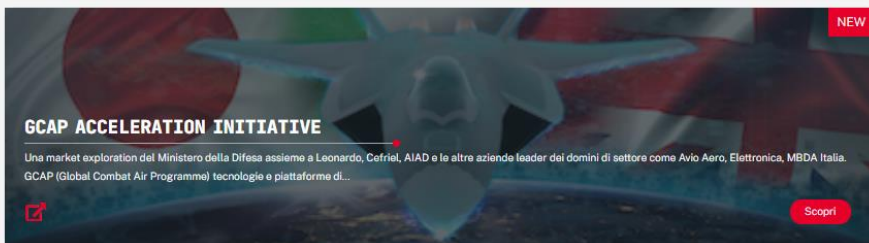
solverswanted.leonardo.com



Solvers Wanted: le Co-Challenge

Co-Challenges

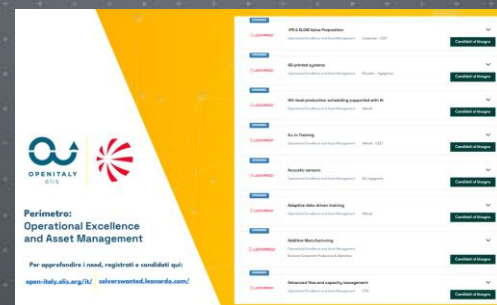
In evidenza



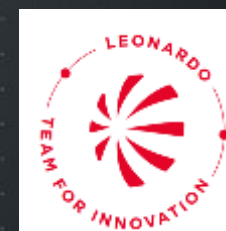
In corso



Chiuse



- la Challenge correlate al GCAP – Global Combat Air Programme (live)
- una prima call assieme alla fondazione Cotec (Enel, Eni) sulla sicurezza sul lavoro (live)
- la call for solution realizzata con Open Italy, con oltre 180 innovation needs pubblicati (closed)



Exploit My Patent

IN PROGRESS CLOSING: JUN 14, 2023

Exploit My Patent

We merge the world of Intellectual Property with that of Open Innovation in a single challenge; an absolute novelty for which Leonardo makes its patented technologies available to solve problems, even in contexts other than those of Aerospace & Defense

61

DAYS

10

HOURS

35

MINUTES

42

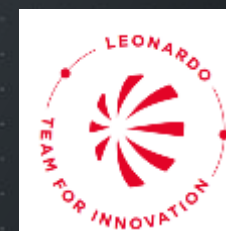
SECONDS

Join now



L'obiettivo della challenge è quello di individuare una o più modalità di applicazione industriale dei brevetti messi a disposizione sulla piattaforma «Solvers Wanted», valorizzando le invenzioni anche in contesti diversi da quelli in cui opera Leonardo.

<https://solverswanted.leonardo.com/it/page/exploits-my-patent-it>



Exploit My Patent

BENEFICI

Perchè partecipare?

€ 20.000

Contributo economico da parte di Leonardo

Licenza d'uso gratuita

Per utilizzare l'invenzione oggetto del Brevetto per la durata massima di 18 mesi

Mentorship e laboratori

Supporto inventore e testing nei laboratori

Affiliazione

Con Leonardo Team for Innovation per promuovere i propri prodotti/servizi

Marketing & Sales

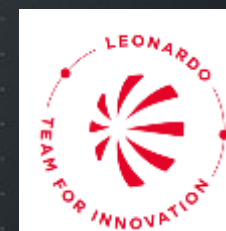
Rapporti diretti con la rete Marketing e Sales Leonardo

Inserimento nell'albo fornitori Leonardo

Per la classe merceologica di riferimento.

- Licenza d'uso gratuita del Brevetto fino a 18 mesi
- 20k€ per realizzazione di un PoC di 12 mesi
- Mentorship dell'Inventore
- Possibilità di Business Plan da proporre a Leonardo




Università, Spin-Off, Start Up, PMI (innovative e non), Centri di Ricerca



Brevetti della challenge

HPRD – High-Pressure Repair Dome **ACTIVE**

Il brevetto riguarda un procedimento per la riparazione di pannelli in materiale composito e il dispositivo utilizzato nel corso del processo di riparazione. Il procedimento intende essere una efficace alternativa alla tecnica del "sacco a vuoto" normalmente utilizzato per la riparazione di difetti di fabbricazione dei pannelli in composito e con una qualità comparabile alle tecniche che utilizzano l'autoclave e che prevedono lo smontaggio dell'elemento da riparare




[Scheda di sintesi](#)  [Scheda di dettaglio](#)  [Specifiche del brevetto](#) 

Partecipa

Il brevetto riguarda un procedimento per la riparazione di pannelli in materiale composito. Una soluzione tecnologica che ha come finalità principale quella di ridurre i costi della riparazione e al tempo stesso di offrire elevati standard di qualità.

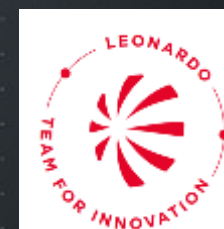
Circuito a fluido per raffreddamento di sistemi elettronici **ACTIVE**

Nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transistori termici, che aumenta la dissipazione verso l'ambiente e limita le escursioni di temperatura a parità di ogni altra condizione, senza peggiorare le caratteristiche d'ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità

[Scheda di sintesi](#)  [Scheda di dettaglio](#)  [Specifiche del brevetto](#) 

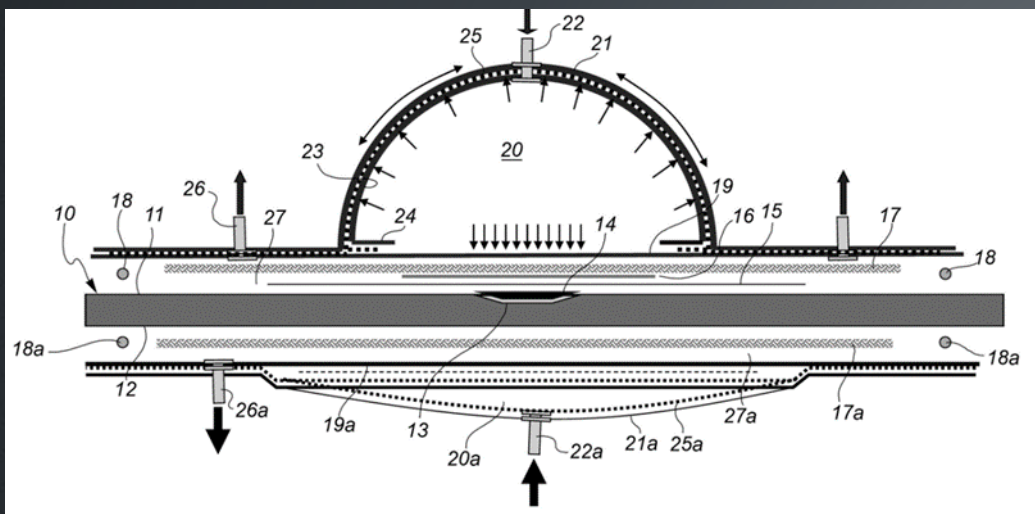
Partecipa

Una nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transistori termici, che aumenta la dissipazione verso ambiente e limita le escursioni di temperatura a parità di ogni altra condizione, senza peggiorare le caratteristiche d'ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità.



HPRD – Un metodo per la riparazione di parti in composito

Il brevetto descrive la procedura di riparazione di laminati costruiti in materiale composito. La procedura è eseguita mediante un dispositivo portatile che permette di utilizzare aria pressurizzata per comprimere una toppa sulla superficie da riparare, precedentemente incisa con taglio angolare lungo i suoi bordi.



HPRD – Idea Concettuale (immagine da brevetto).

Priorità: Marzo 2011
 Deposito italiano TO20100238A1
 Brevetto europeo EP2371523B1
 Brevetto statunitense US8356649B2

Possibili applicazioni:

Materiali	Riparazione strutture in materiale composito
Costruzioni	Pannelli e rivestimenti con funzione anche strutturale
Automotive	Manutenzione parti in composito
Ferroviario	
Navale	Riparazione parti in composito soggette a sollecitazione
Utilities (Eolico/Pipeline)	

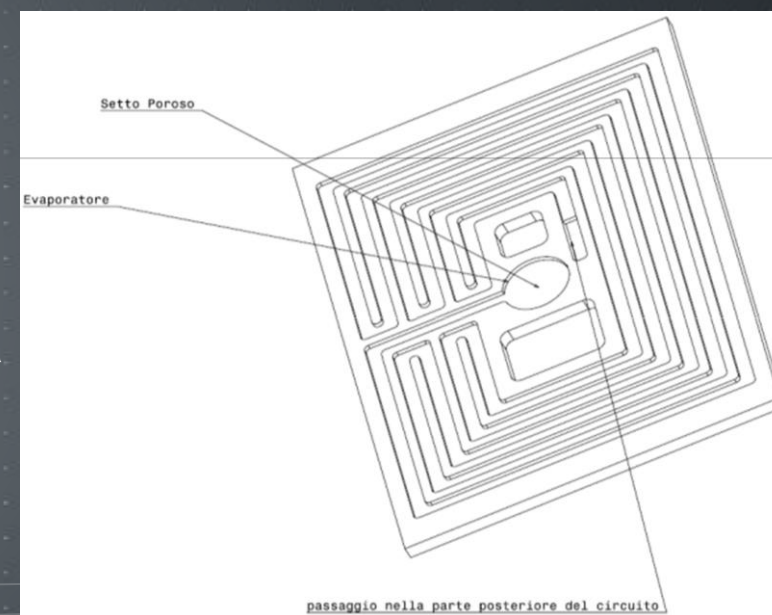
L'invenzione rappresenta un processo innovativo per riparare i laminati in composito, con un'attrezzatura leggera in grado di esercitare pressione sulla toppa di riparazione senza la necessità di smontare le strutture e tornare in autoclave. Il risultato è quello di effettuare riparazioni efficaci dei lavorati in composito con tempi accettabili, con qualità maggiore rispetto al tradizionale sacco a vuoto e paragonabile a quella della riparazione in autoclave.

Circuito a fluido per raffreddamento di sistemi elettronici

L'invenzione rappresenta una nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transistori termici; permette di aumentare la dissipazione verso l'ambiente e di limitare le escursioni di temperatura rispetto alle soluzioni tradizionali, senza peggiorare le caratteristiche d'ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità.

Il brevetto protegge le caratteristiche costruttive e il principio di funzionamento di un circuito a fluido bifase, privo di componenti attivi e con percorso ottimizzato, posto a contatto con le pareti di un apparato elettronico. Il circuito è costituito dai seguenti elementi:

- Un evaporatore di forma circolare disposto sul lato della parete che riceve il calore;
- Una camera di compensazione con forma identica all'evaporatore, ma disposta sul lato della parete che cede il calore all'ambiente esterno;
- Fra evaporatore e camera di compensazione esiste una sottile parete porosa detta Wick, che genera la spinta capillare sul liquido verso l'evaporatore;
- Un circuito distribuito sulle due facce della parete il più lungo e distribuito possibile.



Idea Concettuale (immagine da brevetto).

Possibili applicazioni:

Elettronica	Controllo termico dei dispositivi elettronici a elevata dissipazione, inclusi i PC e i Tablet.
Automotive	Controllo termico dei motori di veicoli elettrificati

Priorità: Dicembre 2016

Deposito italiano IT201600129385A1

Brevetto europeo EP3339789B1


Brevetto statunitense US10228193B2

Brevetto giapponese JP7191511B2


Brevetto Hong Kong HK1256119

Pubblicazione cinese CN108235648A

Exploit My Patent - Profilo Soggetto Innovativo

[Homepage](#)[Mission & Vision](#)[Challenges](#)[News e Storie](#)[Serve aiuto?](#)

[VIEW MODE](#)[INOLTRA SOGGETTO INNOVATIVO](#)



ANAGRAFICA

COMPANY PROFILE

Kroppware

Startup

Candidatura

Challenge Exploit my Patent

Iscrizione Registro delle Imprese

No

Numero di telefono

063570

Sede dell'ente

dei caduti da cavallo, 16, Bugliano, PI, Test. 88044

Sito web

[vai al sito](#)

Anno di costituzione

1970

Partita IVA / codice fiscale


5359681003

Il proponente ha già collaborato con Leonardo?

No

*

Exploit My Patent - Profilo Soggetto Innovativo

 [Homepage](#) [Mission & Vision](#) [Challenges](#) [News e Storie](#) [Serve aiuto?](#)

Soggetto Innovativo

Kroppware

✓

Anagrafica

✎

Company Profile


3

Privacy Policy

DECK COMPANY PROFILE

Carica qui la presentazione dell'ente (non della proposta). Dimensione max. 15 MB

Carica solamente i seguenti formati: pdf, ppt, pptx, zip




 SELEZIONA FILE...

VIDEO PITCH

Dimensione massima: 15 MB

Carica solamente i seguenti formati: avi, mpg, mpeg, 3gp, mov, mp4



 SELEZIONA FILE...

VIDEO PITCH

Exploit My Patent - Partecipazione alla Challenge

[Homepage](#)[Mission & Vision](#)[Challenges ▾](#)[News e Storie](#)[Serve aiuto? ▾](#)

Exploit my patents



Progetto

Caro utente, completa il form per candidarti alla Challenge. In caso di problemi tecnici durante la registrazione, contattaci [qui](#).

CONFERMA LA SOCIETÀ/ENTE CON CUI STAI MANDANDO LA CANDIDATURA *

Kroppware ▾


PER QUALE BREVETTO VUOI INVIARE LA TUA PROPOSTA? *

Per favore seleziona ▾

TITOLO DELLA SOLUZIONE E PAY OFF *

Max 100 caratteri (spazi inclusi)

Exploit My Patent - Partecipazione alla Challenge

 [Homepage](#) [Mission & Vision](#) [Challenges ▾](#) [News e Storie](#) [Serve aiuto? ▾](#) [AK](#) [IT](#)

PER QUALE BREVETTO VUOI INVIARE LA TUA PROPOSTA? *

HPRD - High Pressure Repair Dome ▾







































TITOLO DELLA SOLUZIONE E PAY OFF *

Max 100 caratteri (spazi inclusi)


Questa partecipazione è un test, si prega di non tenerne conto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO *

Descrivere brevemente il progetto che la Società/Ente intende realizzare in 12 mesi includendo una panoramica delle principali tecnologie che si intende implementare

B *i* U                                      

Exploit My Patent - Partecipazione alla Challenge


 [Homepage](#) [Mission & Vision](#) [Challenges](#) [News e Storie](#) [Serve aiuto?](#) AK IT


1 2 3 4 5 6 7 8 9

CARICA QUI IL TUO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE *


Il programma di valorizzazione dovrà contenere: tipologia di prodotto; mercato/i di riferimento; possibile clientela; crono programma del POC a 12 mesi; roadmap di sviluppo a valle del POC. Dimensione massima 30 MB


Carica solamente i seguenti formati: pdf


 RIMUOVI




ComLDO_Assemblea Azionisti_09_--

 SELEZIONA FILE...

 RIMUOVI




ComLDO_Assemblea Azionisti_09_--

 SELEZIONA FILE...

ALTRI DOCUMENTI UTILI


Dimensione massima 15 MB

Carica solamente i seguenti formati: pdf, ppt, pptx, zip, jpeg, jpg, png


 SELEZIONA FILE...

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E MODULO *

Cliccando "Accetto" nel box sottostante confermo che accetto il [Regolamento della challenge](#) e sottoscrivo il [Modulo di accettazione del rappresentante](#)



Exploit My Patent - Partecipazione alla Challenge

 [Homepage](#) [Mission & Vision](#) [Challenges](#) [News e Storie](#) [Serve aiuto?](#) AK IT

Carica solamente i seguenti formati: pdf, ppt, pptx, zip, jpeg, jpg, png

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E MODULO *


Cliccando "Accetto" nel box sottostante confermo che accetto il [Regolamento della challenge](#) e sottoscrivo il [Modulo di accettazione del rappresentante](#)

☒ Accetto e sottoscrivo


CARICA QUI IL MODULO DI ACCETTAZIONE FIRMATO *


Dimensione massima 15 MB

Carica solamente i seguenti formati: pdf

 SELEZIONA FILE...

Il file è stato caricato con successo

 RIMUOVI


c80ddd4639ff2f74de97d7ab6ad5b...

[SALVA COME BOZZA](#) [INVIA](#)

Exploit My Patent

- Pagina web della challenge: <https://solverswanted.leonardo.com/it/page/exploits-my-patent-it>
- Per maggiori informazioni: solverswanted@leonardo.com

Leonardo S.p.A. - Technology Transfer Office

technology_transfer@leonardo.com

